**浙江省科学技术奖公示信息表（专家提名）**

提名奖项：科学技术进步奖

|  |  |
| --- | --- |
| 成果名称 | 大算力芯片测试关键技术与产业化 |
| 提名等级 | 一等奖 |
| 提名书相关内容 | 提名书的主要知识产权和标准规范目录、代表性论文专著目录（详见附页一、附页二）。 |
| 主要完成人 | 丁勇，排名1，教授，浙江大学；徐振，排名2，副教授，杭州芯云半导体集团有限公司；陈冰，排名3，教授，西安电子科技大学杭州研究院；林佳颖，排名4，运营总经理，河南昆仑技术有限公司；李其朋，排名5，教授，浙江科技大学；韩根全，排名6，教授，西安电子科技大学杭州研究院；李志凯，排名7，项目总监，杭州芯云半导体集团有限公司；温长胜，排名8，副研究员，杭州朗迅科技股份有限公司；卓婧，排名9，副教授，杭州朗迅科技股份有限公司；丁盛峰，排名10，研发总监，杭州朗迅科技股份有限公司；俞伟生，排名11，研发总监，河南昆仑技术有限公司。 |
| 主要完成单位 | 1.单位名称：杭州芯云半导体集团有限公司2.单位名称：浙江大学3.单位名称：西安电子科技大学杭州研究院4.单位名称：河南昆仑技术有限公司5.单位名称：杭州朗迅科技股份有限公司6.单位名称：浙江科技大学 |
| 提名专家 | （联合提名）专家姓名1（责任专家）：时龙兴、工作单位：东南大学、职称：教授、学科专业：微电子学与固体电子学； 专家姓名2：年夫顺、工作单位：中国电子科技集团公司第四十一研究所、职称：研究员、学科专业：电子测量仪器； 专家姓名3：孙伟锋、工作单位：东南大学、职称：教授、学科专业：微电子学与固体电子学。  |
| 提名意见 | 成果面向高性能芯片自主可控战略需求，成功构建了我国首套完全自主的大算力高性能芯片自动化测试平台，建立了自主可控的成套测试技术与装备体系，突破了大算力异构集成芯片的测试技术瓶颈，为我国高端芯片的可靠交付提供了测试保障，尤其保障了H公司5G和AI等7nm制程以下芯片的大规模量产测试。成果已获发明专利106件、软件著作权127项、制定国家标准2项，发表论文68篇，三年创造直接经济效益74亿元以上，经济和社会效益显著。提名该成果为省科学技术进步奖一等奖。 |

附页一

**主要知识产权和标准规范目录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识产权（标准规范）类别 | 知识产权（标准规范）具体名称 | 国家（地区） | 授权号（标准规范编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准规范批准发布部门） | 权利人（标准规范起草单位） | 发明人（标准规范起草人） | 发明专利（标准规范）有效状态 |
| 授权发明专利 | 一种用于半导体测试的实时监控方法及装置 | 中国 | ZL202311826343.9 | 2024-03-22 | 第6818668号 | 杭州芯云半导体集团有限公司 | 徐振、李志凯、丁盛峰 | 有效 |
| 授权发明专利 | 一种集成多个测试温度区的晶圆测试系统及测试方法 | 中国 | ZL202311008507.7 | 2023-11-10 | 第6684644号 | 杭州芯云半导体集团有限公司 | 徐振、李志凯 | 有效 |
| 授权发明专利 | 基于静态时序信息的开关电流模型拟合功耗变化波形方法 | 中国 | ZL202011155578.6 | 2022-05-06 | 第5133366号 | 浙江大学 | 丁勇、刘毅、丁越雷、戴悦 | 有效 |
| 授权发明专利 | 一种射频芯片的测试方法及系统 | 中国 | CN202410026408.X | 2024-06-14 | 第7095559号 | 杭州芯云半导体集团有限公司 | 丁盛峰、许闪闪、李志浩、田佳杰、王浩楠 | 有效 |
| 授权发明专利 | 一种提取晶体管器件热特性参数的简单量测方法 | 中国 | ZL202310579078.2 | 2024-03-26 | 第6834291号 | 浙江大学、之江实验室 | 程然、孙颖、陈冰、曲军儒、玉虓 | 有效 |
| 授权发明专利 | 一种高密度探针卡及制备方法、测试方法 | 中国 | ZL202311010393.X | 2023-10-24 | 第6421999号 | 杭州朗迅科技股份有限公司 | 徐振 | 有效 |
| 授权发明专利 | 一种双模组集成电路高频测试设备 | 中国 | ZL202310237824.X | 2023-06-16 | 第6059714号 | 杭州朗迅科技股份有限公司 | 徐振、卓婧 | 有效 |
| 授权发明专利 | 一种基于老化测试的半导体器件分选方法及系统 | 中国 | ZL202311782578.2 | 2024-03-12 | 第6779659号 | 杭州芯云半导体集团有限公司 | 李志凯、丁盛峰、袁雄、吕宏伟 | 有效 |

附页二

**代表性论文专著目录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作 者 | 论文专著名称/刊物 | 年卷页码 | 发表时间（年、月） | 他引总次数 |
| Huang F, Wang BW, Li QP, Zou J | Texture surface defect detection of plastic relays with an enhanced feature pyramid network/ Journal of Intelligent Manufacturing | 2023, 34(3):1409–1425 | 2023、3 | 7 |
| S. Luo, H. Dai, L. Shao and Y. Ding | M3DSSD: Monocular 3D Single Stage Object Detector/2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) | 6141-6150 | 2021.6 | 109 |
| 合 计: | 116 |